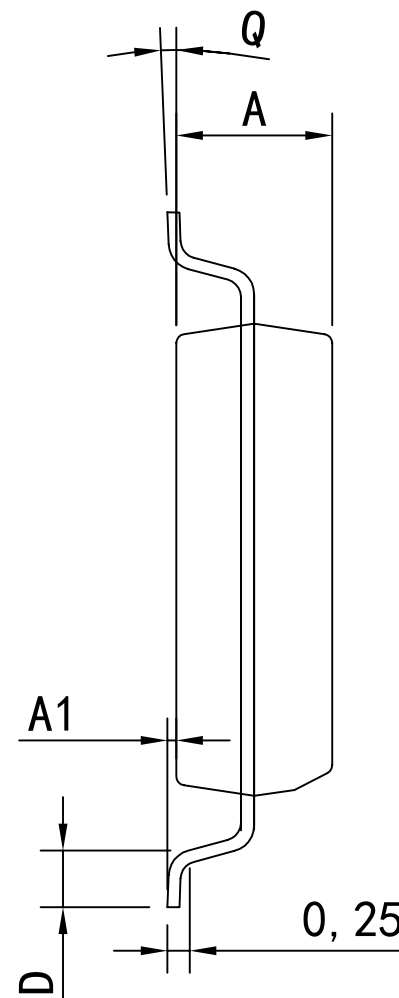
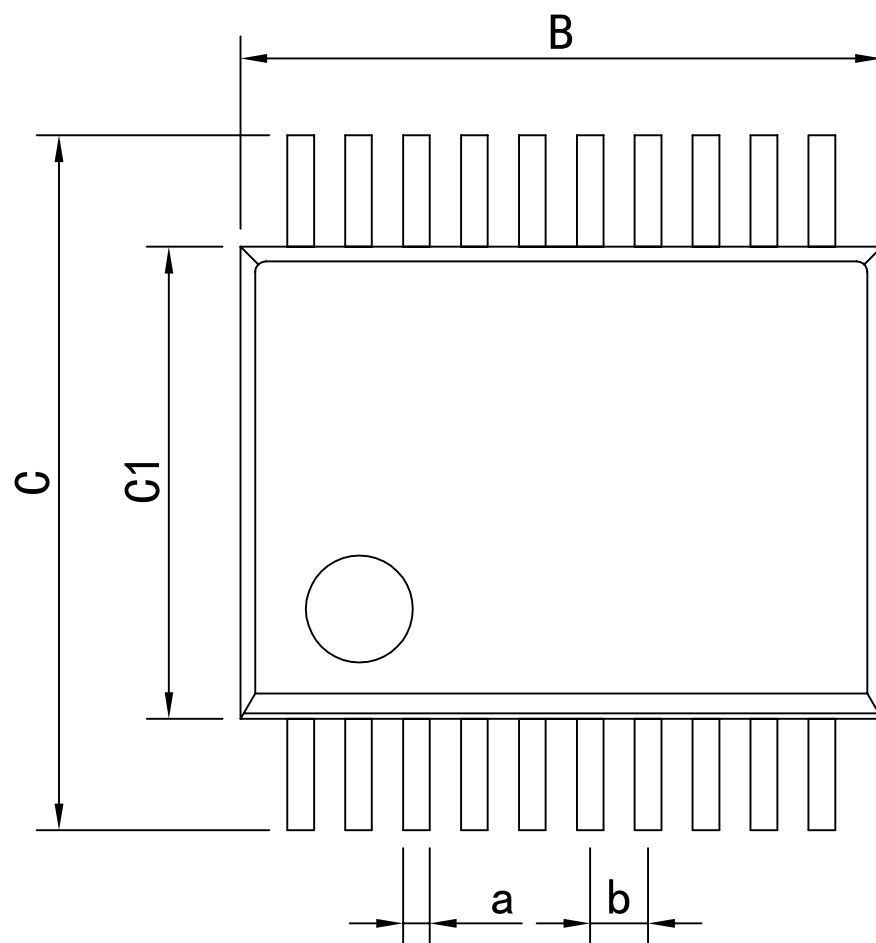




华冠半导体

广东华冠半导体有限公司
Guangdong Huaguan Semiconductor Co., Ltd.



| | |
|----|-----|
| 制图 | 赖谊成 |
| 审阅 | 罗云龙 |
| 核准 | 林钟涛 |

SSOP-20

文件名称:
HG-SSOP20

文件编号:
HGWT-230017

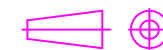
版本 VI.0

比例 1:1

单位 mm

日期 2023-6-28

图纸幅面 A4



第一角法

UNITT : mm

| DIM. | A | A1 | B | C | C1 | D | Q | a | b | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|----|------|------|--|--|--|
| MIN | 1.65 | 0.05 | 6.90 | 7.40 | 5.00 | 0.55 | 0° | 0.20 | 0.65 | | | |
| MAX | 1.85 | 0.15 | 7.50 | 8.20 | 5.60 | 0.95 | 8° | 0.38 | BSC | | | |